

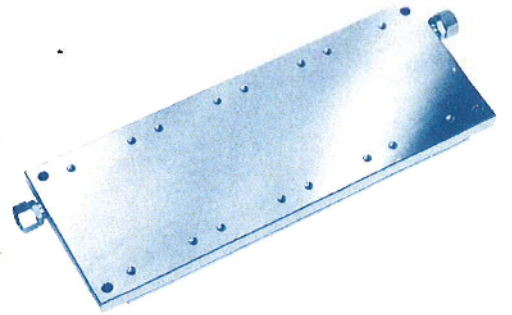
銅製

水冷ヒートシンク

素子の大容量化により、空冷による冷却方法は限界になりつつあります。当社の無酸素銅製水冷ヒートシンクは、厚み6~20mmと空冷の約10分の1、又面積当たり数倍の冷却効果があり省スペース化に貢献します。

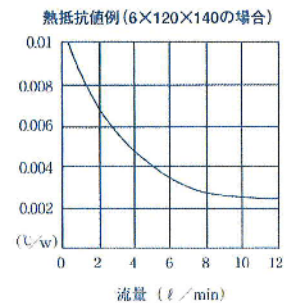
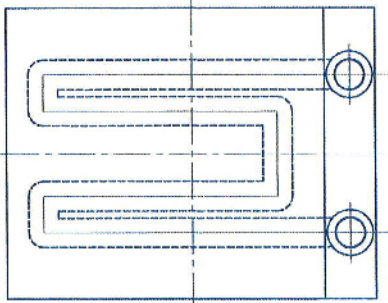
＜用途＞

サイリスタ、IGBT等のパワー素子/SIT、FET等の高周波素子/抵抗体/CPU/ペルチェ素子/各種レーザー/実装基板/その他の発熱体



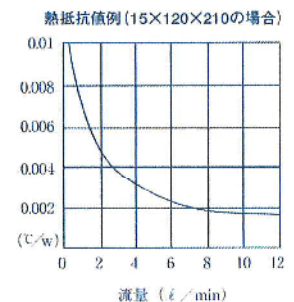
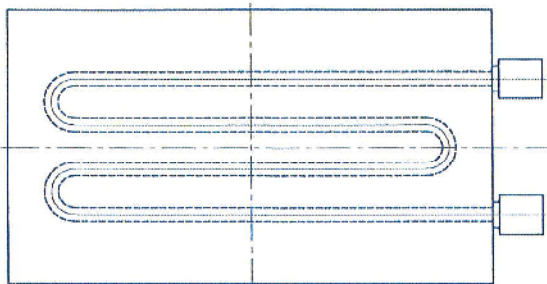
○薄型タイプ

6~10ミリの薄さで機器の軽量化に貢献します。



○両面タイプ

両面に発熱体を取り付けることができ、省スペース化がはかれます。



※IGBT用とペルチェ素子用には標準品もございます。その他のものにつきましてはオーダーメイドとなっておりますので、受熱ブロック寸法、素子取付位置、ニップルの種類等御希望に合わせて製作します。又、特殊形状品につきましても設計、製作できます。(最大50×300×500程度迄)

代理店

Heatsinks & Copperparts

株式会社 高木製作所

〒312-0024 茨城県ひたちなか市勝倉3433

TEL 029-272-4401 (代) FAX 029-272-4403

<http://www5d.biglobe.ne.jp/~heatsink/>